

3次元PCBの製造プロセスおよび用途開発

3次元プリント配線基板(3DPCB)の製造プロセスおよび用途開発として電極付き基板の3次元成形技術の研究開発を進めています。

技術の特長

- 電極付きフレキシブル基板を3次元成形
- 印刷による基板製造工程の短縮

想定される用途

- 自動車のインテリア(インパネ, コンソールの照明・コントローラ等)
- 薄型IoTデバイス

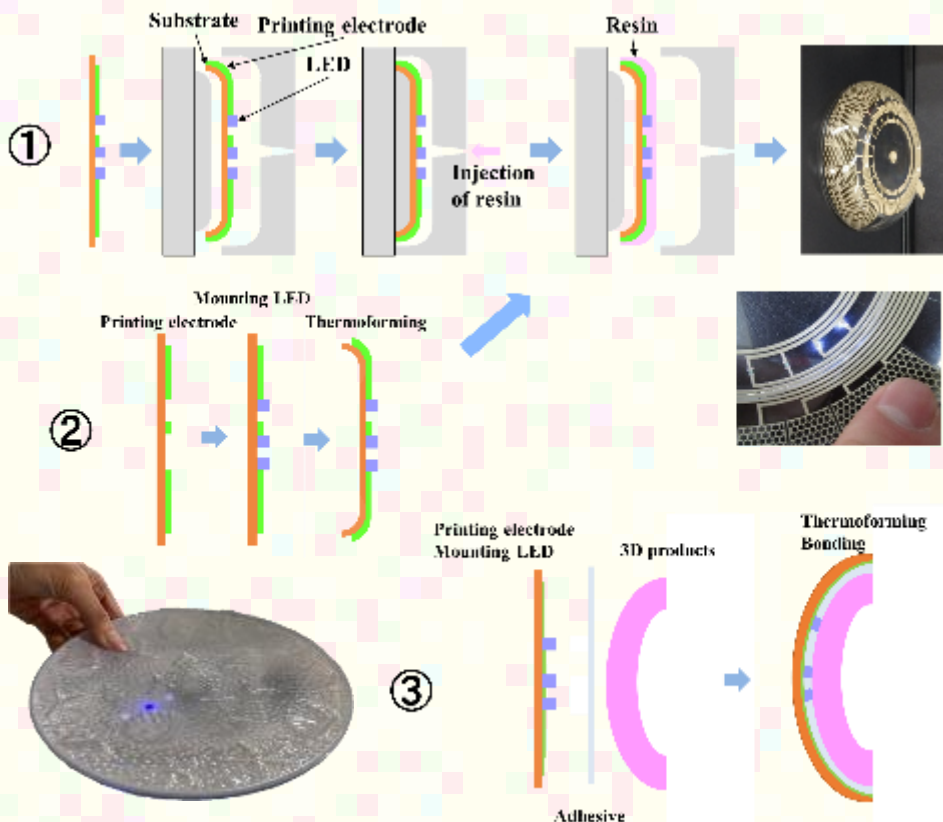
ターゲット製品



農業用センサー

開発技術

タッチスクリーンとLEDを成形品内部にモールドした
三次元形状試作品



共同研究

愛和ライト、日本製鋼所、帝人、藤倉化成、ニシム電子工業

関連プログラム

- JST: 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA) (JPMOP1614)[2016年度~2020年度]
- 文部科学省: オープンイノベーション機構の整備事業「山形大学/オープンイノベーション機構」[2018年度~2022年度]